DELPHION

035576/275

(SEIEGY)

PRODUCTS RESEARCH

INSIDE DELPHION



Search: Quick/Number Boolean Advanced Der

The Delphion Integrated View

Tools: Add to Work File: Create new Work Buy Now: PDF | More choices **⊠** Ema Go to: Derwent View: INPADOC | Jump to: Top

쭝Title:

JP2000345041A2: COMPOSITION FOR FORMING FILM, PRODUCTIC COMPOSITION FOR FORMING FILM, AND MATERIAL FOR FORMING

INSULATION FILM

PDerwent Title:

Composition for film formation for production of semiconductors, comprises a product of hydrolysis and condensation obtained by hydrolyzing and condensing organosilicon compound(s) [Derwent Record]

②Country:

JP Japan

A2 Document Laid open to Public inspection i

NISHIKAWA MICHINORI; TSUNODA MAYUMI; **INOUE YASUTAKE**; YAMADA KINJI:

JSR CORP

News, Profiles, Stocks and More about this company

& Published / Filed:

2000-12-12 / 1999-06-04

₹Application

JP1999000158674

Number:

@IPC Code:

C08L 83/04; C08K 5/06; H01L 21/312; H01L 21/316;

Priority Number:

1999-06-04 JP1999000158674

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a composition having improved storage stability and giving a film improved in uniformity, permittivity, and leak current characteristics by selecting a composition containing a hydrolyzate of a silane compound or a condensate of the hydrolyzate and having a specified propylene alvool content.

SOLUTION: This composition contains at least either of a hydrolyzate and/or a condensate selected from a compound of formula I and a compound of formula II and a solvent of formula III of a purity of 99% (as measured by gas chromatography) and has a propylene glycol content of 10,000 ppm or below. In the formula, R1 is H, F, or a monovalent organic group; R2 to R6 are each a monovalent organic group; a, b, and c are each 0-2; R7 is O or -(CH2)n-; in formula II, n is 1-6; d is 0 or 1; R8 and R9 are each a monovalent organic group selected from H, a 1-4C alkyl, and CH3CO-; and e is 1-2. The composition desirably has an iron content and a sodium content each of which is 15 ppb or below and may contain a β -diketone, a compound having a polyalkylene oxide structure, or the like.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

PINPADOC

None

Buy Now: Family Legal Status Report



Legal Status:
Property Designated
Country:

BE DE FR GB IT NL

₽Family:

Buy PDF	Publication	Pub. Date	Filed	Title		
恩	<u>US6376634</u>	2002-04-23	2000-06-02	Composition for film formation and mainsulating film formation		
Ø	JP2001164113A2	2001-06-19	1999-12-13	COMPOSITION FOR FILM FORMATION MATERIAL FOR FORMING INSULAT		
	JP2000345041A2	2000-12-12	1999-06-04	COMPOSITION FOR FORMING FILM PRODUCTION OF COMPOSITION FORMING FILM, AND MATERIAL FO FORMING INSULATION FILM		
22	EP1058274B1	2005-07-27	2000-05-31	Composition for film formation and mainsulating film formation		
	EP1058274A1	2000-12-06	2000-05-31	Composition for film formation and mainsulating film formation		
	DE60021476C0	2005-09-01	2000-05-31	Beschichtungszusammensetzung für c Filmherstellung und Material für isolier Schichten		
6 f	6 family members shown above					

CHEMABS 134(03)030163H DERABS C2001-204180







Nominate this for the Gallery...



Copyright © 1997-2005 The Thor

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact U

THOMSON

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-345041 (P2000-345041A)

(43)公開日 平成12年12月12日(2000.12.12)

(51) Int. Cl	. 識別記号	FI		テーマコード (参考)
C08L	83/04	C08L	83/04	4J002
C08K	5/06	C08K	5/06	5F058
HO1L	21/312	H01L	21/312 C	
•	21/316		21/316 H	

		審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全12頁)
(21) 出願番号	特願平11-158674	(71)出願人 000004178 ジェイエスアール株式会社
(22)出願日	平成11年6月4日(1999.6.4)	東京都中央区築地2丁目11番24号 (72)発明者 西川 通則 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内
		(72)発明者 角田 真由美 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内
		(72)発明者 井上 靖健 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ ・ エスアール株式会社内
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】膜形成用組成物、膜形成用組成物の製造方法および絶縁膜形成用材料

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、適当な均一な厚さを有する塗膜が形成可能で保存安定性に優れ、塗膜の誘電率やリーク電流特性などに優れた膜形成用組成物。

【解決手段】 (A-1)式(1)で表される化合物

$$R^{1}_{a}Si(OR^{2})_{4-a}$$
 ···· (1)

 $(R^1$ は水素原子、フッ素原子または有機基を、 R^2 は有機基を示す。)および(A-2)式(2)で表される化合物

$$R_b^3 (R^{40})_{3-b} S i - (R^7)_{d} - S i (OR^5)_{3-c} R_c^6$$

 $(R^3, R^4, R^5$ および R^6 は、有機基を、 R^7 は酸素原子または-(CH2)。-、nは1~6、dは0または1を示す。)から選ばれる化合物の加水分解物、縮合物(B)式(3)で表される溶剤

$$R^{8}O$$
 (CHCH₃CH₂O) $_{e}R^{9}$ (3)

(R"および R"は、水素原子、アルキル基または CH,CO-を示し、eは1~2。)を含有し、プロピレングリコールの含有量が<math>10000ppm以下の膜形成用組成物。

【特許請求の範囲】

(A) (A-1) 下記一般式(1) で表 【請求項1】 される化合物

1

 $\cdots \cdots (1)$ R^1 . S i (OR^2) ...

$$R^{3}_{b}$$
 (R⁴O) _{3-b} S i - (R¹) ₄ - S i (OR⁵) _{3-c} R⁶, (2)

(R', R', R5およびR6は、同一でも異なっていても よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同 ーでも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R'は 酸素原子または- (CH2)。-で表される基を示し、n 10 R'O (CHCH, CH2O), R'

(R°およびR°は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。)を含有 し、かつプロピレングリコールの含有量が10000p pm以下であることを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 ナトリウム含有量および鉄含有量がそれ ぞれ15ppb以下であることを特徴とする請求項1記 載の膜形成用組成物。

(C) 触媒が下記一般式 (4) で表され 20 される化合物 【請求項3】 る金属のキレート化合物であることを特徴とする請求項 2 記載の膜形成用組成物の製造方法。

 $\cdots \cdots (4)$ R", M (OR") e-r

(R"はキレート剤、Mは金属原子、R"は炭素数2~ 5のアルキル基または炭素数6~20のアリール基を示 し、gは金属Mの原子価、fは1~gの整数を表す。)

$$R^{3}_{b}$$
 (R⁴O) ₃₊ Si - (R⁷) ₄ - Si (OR⁵) _{3-c} R⁶,
· · · · · (2)

(R'、R'、R'およびR'は、同一でも異なっていても ーでも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R'は 酸素原子またはー(CH2)。一で表される基を示し、 d R'O (CHCH, CH, O), R'

(R°およびR°は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 1~4のアルキル基またはCH, CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。) および

(C) 触媒の存在下で加水分解することを特徴とする請 求項1記載の膜形成用組成物の製造方法。

【請求項7】 請求項1~6記載の膜形成用組成物から なることを特徴とする絶縁膜形成用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 縁膜材料として、適当な均一な厚さを有する塗膜が形成 可能で保存安定性に優れ、しかも塗膜の誘電率やリーク 電流特性などに優れた膜形成用組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで以て形成され 50 絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、

(R'は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、R²は1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表 す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化 合物

は1~6を、dは0または1を示す。) からなる群より 選ばれる少なくとも1種の化合物の加水分解物および縮 合物もしくはいずれか一方ならびに(B)下記一般式

(3)で表される溶剤 $\cdots (3)$

(C) 触媒が酸触媒であることを特徴と 【請求項4】 する請求項2記載の膜形成用組成物の製造方法。

【請求項5】 さらにβージケトン、ポリアルキレンオ キシド構造を有する化合物および(メタ)アクリル系重 合体よりなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物を 含有することを特徴とする請求項1または2記載の膜形 成用組成物。

(A) (A-1) 下記一般式(1) で表 【請求項6】

 R^{1} , S i (OR^{2}) ...

(R'は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、R²は1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表 す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化

は0または1を示す。) からなる群より選ばれる少なく よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同 30 とも1種の化合物を(B)下記一般式(3)で表され、 ガスクロマトグラフィーで測定した場合の純度が99% 以上である溶剤

. (3)

たシリカ (SiO2) 膜が多用されている。そして、 近年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的とし て、SOG (Spin onGlass) 膜と呼ばれる テトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする **塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、** 半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれ 40 るポリオルガノシロキサンを主成分とする低誘電率の層 間絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導体素子 などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導 体間の電気絶縁性が要求されており、したがって、保存 安定性が良好でより低誘電率でリーク電流特性に優れる 層間絶縁膜材料が求められるようになっている。

【0003】そこで、特開平6-181201号公報に は、層間絶縁膜材料として、より低誘電率の絶縁膜形成 用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物 は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の

チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ば れる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分 子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素 化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以 上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成 物である。

【0004】また、WO96/00758号公報には、 多層配線基板の層間絶縁膜の形成に使用される、アルコ キシシラン類、シラン以外の金属アルコキシドおよび有 機溶媒などからなる、厚膜塗布が可能で、かつ耐酸素プ ラズマ性に優れるシリカ系塗布型絶縁膜形成用材料が開 示されている。

【0005】さらに、特開平3-20377号公報に は、電子部品などの表面平坦化、層間絶縁などに有用な 酸化物被膜形成用塗布液が開示されている。この酸化物 被膜形成用塗布液は、ゲル状物の発生のない均一な塗布 液を提供し、また、この塗布液を用いることにより、高 温での硬化、酸素プラズマによる処理を行った場合であ っても、クラックのない良好な酸化物被膜を得ることを 目的としている。そして、その構成は、所定のシラン化 20 合物 合物と、同じく所定のキレート化合物とを有機溶媒の存

$$R^{3}_{b}$$
 (R⁴O) 3. Si - (R⁷) .-Si (OR⁵) 3. R⁶. ... (2)

(R³、R¹、R⁵およびR¹は、同一でも異なっていても よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよび c は、同 ーでも異なっていてもよく、O~2の数を示し、R'は 酸素原子または- (CH2)。-で表される基を示し、n は1~6を、dは0または1を示す。)から選ばれる少 R'O (CHCH, CH2O) . R'

(R°およびR°は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 30 オロフェニル基などを挙げることができる。 $1 \sim 4$ のアルキル基またはCH, CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、 e は 1 ~ 2 の整数を表す。) を含有 することを特徴とする膜形成用組成物、その製造方法お よび絶縁膜形成用材料を提供するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】

【0010】 (A) 成分

(A-1) 成分

上記一般式 (1) において、R'およびR'の1価の有機 基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリ シジル基などを挙げることができる。また、一般式

(1) において、R'は1価の有機基、特にアルキル基 またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アル キル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブ チル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であ り、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよ く、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていて もよい。一般式(1)において、アリール基としては、 フェニル甚、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフ 在化で加水分解し、重合して得られる酸化物被膜形成用 途布液である。

【0006】しかし、上記のようにシラン化合物にチタ ンやジルコニウムなどの金属キレート化合物を組み合せ た場合、金膜の均一性や保存安定性が優れず、さらに誘 電率、リーク電流などをバランスよく有するものではな V.

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しく は、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、塗膜均 一性や保存安定性に優れ、誘電率やリーク電流特性にも 優れた層間絶縁膜用材料を提供することを目的とする。 【0008】本発明は、(A)(A-1)下記一般式 (1) で表される化合物

 $R'aSi'(OR^2)$ 4-a $\cdots \cdots (1)$ (R'は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、R²は1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表 す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化

なくとも1種の化合物の加水分解物および縮合物もしく はいずれか一方ならびに(B)下記一般式(3)で表さ れ、ガスクロマトグラフィーで測定した場合の純度が9 9%である溶剤

 \dots (3)

【0011】一般式(1)で表される化合物の具体例と しては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、ト リーn-プロポキシシラン、トリーiso-プロポキシ シラン、トリーnーブトキシシラン、トリーsecーブ トキシシラン、トリーtert-ブトキシシラン、トリ フェノキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フル オロトリエトキシシラン、フルオロトリーnープロポキ シシラン、フルオロトリーiso-プロポキシシラン、 フルオロトリーn-ブトキシシラン、フルオロトリー s 40 ecーブトキシシラン、フルオロトリーtertーブト キシシラン、フルオロトリフェノキシシラン、テトラメ トキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーnープ ロポキシシラン、テトラーisoープロポキシシラン、 テトラーn-ブトキシラン、テトラ-sec-ブトキシ シラン、テトラーtertーブトキシシラン、テトラフ ェノキシシランなど; メチルトリメトキシシラン、メチ ルトリエトキシシラン、メチルトリーn-プロポキシシ ラン、メチルトリーiso-プロポキシシラン、メチル トリーnーブトキシシラン、メチルトリーsecーブト ェニル甚、クロロフェニル基、プロモフェニル基、フル 50 キシシラン、メチルトリーtertーブトキシシラン、

メチルトリフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラ ン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリーnープロ ポキシシラン、エチルトリーiso-プロポキシシラ ン、エチルトリーnーブトキシシラン、エチルトリーs ecーブトキシシラン、エチルトリーtertーブトキ シシラン、エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメ トキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリ -n-プロポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポ キシシラン、ビニルトリーnープトキシシラン、ビニル トリーsec-ブトキシシラン、ビニルトリーtert ープトキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキ シシラン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、 n-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、n-プ ロピルトリーnーブトキシシラン、nープロピルトリー sec-ブトキシシラン、n-プロピルトリーtert ープトキシシラン、nープロピルトリフェノキシシラ ン、iープロピルトリメトキシシラン、iープロピルト リエトキシシラン、i-プロピルトリ-n-プロポキシ シラン、iープロピルトリーisoープロポキシシラ ン、iープロピルトリーnーブトキシシラン、iープロ ピルトリーsec-ブトキシシラン、i-プロピルトリ -tert-ブトキシシラン、i-プロピルトリフェノ キシシラン、nーブチルトリメトキシシラン、nーブチ ルトリエトキシシラン、nーブチルトリーnープロポキ シシラン、n-ブチルトリーiso-プロポキシシラ ン、n-ブチルトリーn-ブトキシシラン、n-ブチル トリーsecーブトキシシラン、nーブチルトリーte r t ープトキシシラン、n ープチルトリフェノキシシラ ン、sec-ブチルトリメトキシシラン、sec-ブチ 30 ルーi-トリエトキシシラン、sec-ブチル-トリー nープロポキシシラン、secーブチルートリーiso ープロポキシシラン、secーブチルートリーnーブト キシシラン、sec-ブチル-トリーsec-ブトキシ シラン、sec-ブチルートリーtert-ブトキシシ ラン、secーブチルートリフェノキシシラン、tーブ チルトリメトキシシラン、tーブチルトリエトキシシラ ン、tーブチルトリーnープロポキシシラン、tーブチ ルトリーiso-プロポキシシラン、t-ブチルトリー n-ブトキシシラン、t-ブチルトリーsec-ブトキ 40 シシラン、tーブチルトリーtertーブトキシシラ ン、t-ブチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメ トキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニル トリーnープロポキシシラン、フェニルトリーiso-プロポキシシラン、フェニルトリーnープトキシシラ ン、フェニルトリーsec-ブトキシシラン、フェニル トリーtert-ブトキシシラン、フェニルトリフェノ キシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエ トキシシラン、γーアミノプロピルトリメトキシシラ

シドキシプロピルトリメトキシシラン、γーグリシドキ シプロピルトリエトキシシラン、γートリフロロプロピ ルトリメトキシシラン、γートリフロロプロピルトリエ トキシシランなど;ジメチルジメトキシシラン、ジメチ ルジエトキシシラン、ジメチルージーn-プロポキシシ ラン、ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメ チルージーnーブトキシシラン、ジメチルージーsec ープトキシシラン、ジメチルージーtertープトキシ シラン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメト 10 キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージ -n-プロポキシシラン、ジエチルージーiso-プロ ポキシシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジ エチルージー s e c ーブトキシシラン、ジエチルージー tertーブトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラ ン、ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロ ピルジエトキシシラン、ジーn-プロピルージ-n-プ ロポキシシラン、ジーn-プロピルージーiso-プロ ポキシシラン、ジーnープロピルージーnープトキシシ ラン、ジーnープロピルージーsecーブトキシシラ 20 ン、ジーnープロピルージーtertーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーフェノキシシラン、ジーi so-プロピルジメトキシシラン、ジーiso-プロピ ルジエトキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-プロポキシシラン、ジーiso-プロピルージーiso ープロポキシシラン、ジーisoープロピルージーnー ブトキシシラン、ジーisoープロピルージーsec-ブトキシシラン、ジーisoープロピルージーtert ープトキシシラン、ジー i s o ープロピルージーフェノ キシシラン、ジーn-ブチルジメトキシシラン、ジーn ープチルジエトキシシラン、ジーnープチルージーnー プロポキシシラン、ジーnーブチルージーisoープロ ポキシシラン、ジーnーブチルージーnーブトキシシラ ン、ジーnーブチルージーsecーブトキシシラン、ジ -n-ブチルージーtert-ブトキシシラン、ジーn ーブチルージーフェノキシシラン、ジーsecーブチル ジメトキシシラン、ジーsecーブチルジエトキシシラ ン、ジーsecーブチルージーnープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーisoープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーs e c ーブチルージーsecーブトキシシラン、ジーse cーブチルージーtertープトキシシラン、ジーse cーブチルージーフェノキシシラン、ジーtertープ チルジメトキシシラン、ジーtert-ブチルジエトキ シシラン、ジーtertーブチルージーnープロポキシ シラン、ジーtertーブチルージーisoープロポキ シシラン、ジーtertーブチルージーnープトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーsecーブトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーtertーブトキシ シラン、ジーtertーブチルージーフェノキシシラ ン、γーアミノプロピルトリエトキシシラン、γーグリ 50 ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエ

トキシシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラ ン、ジフェニルージーisoープロポキシシラン、ジフ ェニルージー n ープトキシシラン、ジフェニルージー s e c ーブトキシシラン、ジフェニルージー t e r t ーブ トキシシラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニ ルトリメトキシシラン、γ-アミノプロピルトリメトキ シシラン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン、γ **ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γーグリ** シドキシプロピルトリエトキシシラン、γートリフロロ トリエトキシシランなど;を挙げることができる。好ま、 しくは、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラ ン、テトラーnープロポキシシラン、テトラーiso-プロポキシシラン、テトラフェノキシシラン、メチルト リメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチル トリーnープロポキシシラン、メチルトリーisoープ ロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルト リエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニル トリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ ェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラ ン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシ ラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキ シシラン、ジフェニルジエトキシシラン、トリメチルモ ノメトキシシラン、トリメチルモノエトキシシラン、ト リエチルモノメトキシシラン、トリエチルモノエトキシ シラン、トリフェニルモノメトキシシラン、トリフェニ ルモノエトキシシランである。これらは、1種あるいは 2種以上を同時に使用してもよい。

【0012】(A-2)成分

の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。 また、一般式(2)のR'である2価の有機基として は、メチレン基、炭素数2~6のアルキレン基などを挙 げることができる。一般式 (2) のうち、R'が酸素原 子の化合物としては、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘ キサエトキシジシロキサン、ヘキサフェノキシジシロキ サン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシー3-メチ ルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3ーペンタエトキシ -3-メチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペン タメトキシー3-フェニルジシロキサン、1,1,1, 3. 3ーペンタエトキシー3ーフェニルジシロキサン、 1, 1, 3, 3-テトラメトキシー1, 3-ジメチルジ シロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3 ージメチルジシロキサン、1,1,3,3ーテトラメト キシー1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジフェニルジシロキサ ン、1, 1, 3-トリメトキシー1, 3, 3ートリメチ ルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシー1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1,1,3-トリメトキ シー1, 3, 3ートリフェニルジシロキサン、1, 1,

3-トリエトキシー1, 3, 3-トリフェニルジシロキ サン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメ チルジシロキサン、1、3-ジエトキシ-1、1、3、 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシー 1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3 -ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロ キサンなどを挙げることができる。これらのうち、ヘキ サメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサ ン、1, 1, 3, 3ーテトラメトキシー1, 3ージメチ プロピルトリメトキシシラン、γートリフロロプロピル 10 ルジシロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラエトキシー 1. 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テト ラメトキシー1、3ージフェニルジシロキサン、1、3 -ジメトキシ-1,1,3,3-テトラメチルジシロキ サン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメ チルジシロキサン、1、3-ジメトキシ-1、1、3、 3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジエトキシ -1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなど を、好ましい例として挙げることができる。一般式 (2) において dが 0 の化合物としては、ヘキサメトキ 20 シジシラン、ヘキサエトキシジシラン、ヘキサフェニキ シジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーペンタメトキシー2 ーメチルジシラン、1,1,1,2,2ーペンタエトキ シー 2-メチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタ メトキシー2-フェニルジシラン、1,1,1,2,2 -ペンタエトキシー2-フェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、 1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジメチルジ シラン、1, 1, 2, 2ーテトラメトキシー1, 2ージ フェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー 上記一般式 (2) において、1 価の有機基としては、先 30 1, 2 - ジフェニルジシラン、1, 1, 2 - トリメトキ シー1, 2, 2-トリメチルジシラン、1, 1, 2-ト リエトキシー1, 2, 2ートリメチルジシラン、1, 1. 2-トリメトキシー1, 2, 2-トリフェニルジシ ラン、1, 1, 2ートリエトキシー1, 2, 2ートリフ ェニルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2 -テトラメチルジシラン、1,2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキ シー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシラン、1, 2 -ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラ 40 ンなどを、一般式 (2) においてR'がー (CH2) n-で表される基の化合物としては、ビス(ヘキサメトキシ シリル) メタン、ビス (ヘキサエトキシシリル) メタ ン、ビス (ヘキサフェノキシシリル) メタン、ビス(ジ メトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジエトキシメチ ルシリル) メタン、ビス (ジメトキシフェニルシリル) メタン、ビス (ジエトキシフェニルシリル) メタン、ビ ス (メトキシジメチルシリル) メタン、ビス (エトキシ ジメチルシリル) メタン、ビス (メトキシジフェニルシ リル) メタン、ビス (エトキシジフェニルシリル) メタ 50 ン、ビス (ヘキサメトキシシリル) エタン、ビス (ヘキ

サエトキシシリル) エタン、ビス (ヘキサフェノキシシ リル) エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) エタ ン、ビス (ジエトキシメチルシリル) エタン、ビス (ジ メトキシフェニルシリル) エタン、ビス (ジエトキシフ ェニルシリル) エタン、ビス(メトキシジメチルシリ ル) エタン、ビス (エトキシジメチルシリル) エタン、 ビス (メトキシジフェニルシリル) エタン、ビス (エト キシジフェニルシリル) エタン、1, 3-ビス (ヘキサ メトキシシリル) プロパン、1, 3-ビス (ヘキサエト キシシリル)プロパン、1,3-ビス(ヘキサフェノキ シシリル)プロパン、1,3-ビス(ジメトキシメチル シリル) プロパン、1,3-ビス(ジエトキシメチルシ リル) プロパン、1, 3ービス (ジメトキシフェニルシ リル) プロパン、1, 3-ビス (ジエトキシフェニルシ リル) プロパン、1, 3-ビス (メトキシジメチルシリ ル) プロパン、1, 3-ビス (エトキシジメチルシリ ル) プロパン、1, 3ービス(メトキシジフェニルシリ ル) プロパン、1, 3-ビス (エトキシジフェニルシリ ル) プロパンなどを挙げることができる。これらのう ち、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラ ン、ヘキサフェニキシジシラン、1,1,2,2ーテト ラメトキシー1, 2ージメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1,

RO (CHCH, CH2O) . R' (R°およびR°は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。) であ る。ここで、溶剤1のガスクロマトグラフィーにより測 定した純度は99%以上、好ましくは99.5%以上で エーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、 プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレ ングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコー ルジメチルエーテル、プロピレングリコールジエチルエ ーテル、プロピレングリコールジプロピルエーテル、プ ロピレングリコールジブチルエーテル、ジプロピレング リコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコール モノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロ ピルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエー ロピレングリコールジエチルエーテル、ジプロピレング リコールジプロピルエーテル、ジプロピレングリコール ジブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールモノプロピル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノブチル エーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチ ルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノエ チルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノ プロピルエーテルアセテート、ジプロピレングリコール 50 1,200~100,000程度である。

1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジフェニルジシ ラン、1, 1, 2, 2ーテトラエトキシー1, 2ージフ ェニルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2 -テトラメチルジシラン、1,2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキ シー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシラン、1, 2 -ジエトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラ ン、ビス(ヘキサメトキシシリル)メタン、ビス(ヘキ ·サエトキシシリル) メタン、ビス (ジメトキシメチルシ 10 リル) メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタ ン、ビス (ジメトキシフェニルシリル) メタン、ビス (ジエトキシフェニルシリル) メタン、ビス (メトキシ ジメチルシリル) メタン、ビス (エトキシジメチルシリ ル) メタン、ビス (メトキシジフェニルシリル) メタ ン、ビス (エトキシジフェニルシリル) メタンを、好ま しい例として挙げることができる。本発明において、 (A) 成分としては、上記 (A-1) 成分および (A-2) 成分、もしくはいずれか一方を用い、(A-1) 成 分および (A-2) 成分はそれぞれ 2種以上用いること 20 もできる。

10

【0013】(B)成分

本発明の(B)成分は下記一般式(3)で表される溶剤 (以下「溶剤1」という)

. (3)

モノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコール ジアセテート、ジプロピレングリコールジアセテートな どが挙げられ、特にプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プ ロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレン ある。溶剤1としては、ロピレングリコールモノメチル 30 グリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコール ジメチルエーテル、プロピレングリコールジエチルエー テル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ ート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテ ート、プロピレングリコールモノプロピルエーテルアセ テートが好ましい。これらは1種または2種以上を同時 に使用することができる。

【0014】本発明において、加水分解とは、上記 (A) 成分に含まれるR'O-基、R'O-基、およびR *O-基すべてが加水分解されている必要はなく、例え テル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、ジプ 40 ば1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水 分解されているもの、あるいは、これらの混合物が生成 することである。本発明において縮合とは(A)成分の 加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結 合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基 がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノ ール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているもの の混合物などをも生成することを包含した概念である。 なお、(A) 成分の加水分解縮合物の重量平均分子量 は、通常、1,000~120,000、好ましくは

【0015】本発明において(B)成分の使用量は(A)成分(完全加水分解縮合物換算)0.3~25倍量(重量)の範囲である。なお、本発明において完全加水分解縮合物とは、(A)成分に含まれるR²O-基、およびR³O-基が100%加水分解してOULL となり、完全に縮合したものを示す。

11

H基となり、完全に縮合したものを示す。 【0016】本発明の膜形成用組成物は、さらに下記の 有機溶剤を溶剤1の50重量%以下含有していてもよ い。本発明に使用する有機溶剤としては、例えば、n-ペンタン、iーペンタン、nーヘキサン、iーヘキサ ン、nーヘプタン、iーヘプタン、2, 2, 4ートリメ チルペンタン、nーオクタン、 i ーオクタン、シクロへ キサン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素系 溶媒 ; ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼ ン、トリメチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、n-プロピルベンセン、 i ープロピルベンセン、ジエチルベ ンゼン、 i ープチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ジ -i-プロピルベンセン、n-アミルナフタレン、トリ メチルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶媒;;アセト ン、メチルエチルケトン、メチルーnープロピルケト ン、メチルーn-ブチルケトン、ジエチルケトン、メチ ルーiーブチルケトン、メチルーn-ペンチルケトン、 エチルーnーブチルケトン、メチルーnーヘキシルケト ン、ジーiーブチルケトン、トリメチルノナノン、シク ロヘキサノン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノ ン、2、4ーペンタンジオン、アセトニルアセトン、ジ アセトンアルコール、アセトフェノン、フェンチョンな どのケトン系溶媒;エチルエーテル、 i ープロピルエー テル、n ープチルエーテル、n ーヘキシルエーテル、2 -エチルヘキシルエーテル、エチレンオキシド、1,2 ープロピレンオキシド、ジオキソラン、4ーメチルジオ キソラン、ジオキサン、ジメチルジオキサン、エチレン グリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモ ノエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテ ル、エチレングリコールモノー n ーブチルエーテル、エ チレングリコールモノーn-ヘキシルエーテル、エチレ ングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコー ルモノー2ーエチルブチルエーテル、エチレングリコー ルジブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチル エーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、 ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレング リコールモノーnープチルエーテル、ジエチレングリコ ールジーnーブチルエーテル、ジエチレングリコールモ ノー n ーヘキシルエーテル、エトキシトリグリコール、 テトラエチレングリコールジー n – ブチルエーテル、ト リプロピレングリコールモノメチルエーテル、テトラヒ ドロフラン、2-メチルテトラヒドロフランなどのエー テル系溶媒;ジエチルカーボネート、酢酸メチル、酢酸 エチル、γーブチロラクトン、γーバレロラクトン、酢 酸n-プロピル、酢酸i-プロピル、酢酸n-ブチル、

酢酸iーブチル、酢酸secーブチル、酢酸nーペンチ ル、酢酸sec-ペンチル、酢酸3-メトキシブチル、 酢酸メチルペンチル、酢酸2-エチルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘキシル、 酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸n-ノニル、アセト酢 酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレングリコール モノメチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノエチ ルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノメチルエー テル、酢酸ジエチレングリコールモノエチルエーテル、 10 酢酸ジエチレングリコールモノーn-ブチルエーテル、 酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エチル、プ ロピオン酸n-ブチル、プロピオン酸 i ーアミル、シュ ウ酸ジエチル、シュウ酸ジーnープチル、乳酸メチル、 乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミル、マロン 酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなど のエステル系溶媒;Nーメチルホルムアミド、N, Nー ジメチルホルムアミド、N,Nージエチルホルムアミ ド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルプロピオンアミド、 20 N-メチルピロリドンなどの含窒素系溶媒;硫化ジメチ ル、硫化ジエチル、チオフェン、テトラヒドロチオフェ ン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、1,3-プロ パンスルトンなどの含硫黄系溶媒などを挙げることがで きる。これらは、1種あるいは2種以上を混合して使用 することができる。

【0017】本発明の膜形成用組成物は、さらに下記のような成分を含有してもよい。

β - ジケトン

 β -ジケトンとしては、アセチルアセトン、2、4-へ30 キサンジオン、2、4-ヘプタンジオン、3、5-ヘプタンジオン、2、4-オクタンジオン、3、5-オクタンジオン、2、4-ノナンジオン、3、5-ノナンジオン、5-メチル-2、4-ヘキサンジオン、2、2、6、6-テトラメチル-3、5-ヘプタンジオン、1、1、1、5、5、5-ヘキサフルオロ-2、4-ヘプタンジオンなどの1種または2種以上である。本発明において、膜形成用組成物中の β -ジケトン含有量は、

(A) 成分(完全加水分解縮合物換算)の合計量100 重量部に対して通常0.1~100重量部、好ましくは 0.2~80重量部の範囲である。このような範囲でβ ージケトンを添加すれば、一定の保存安定性が得られる とともに、膜形成用組成物の塗膜均一性などの特性が低 下するおそれが少ない。このβージケトンは、(A) 成 分の加水分解、縮合反応後に添加することが好ましい。

【0018】その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド 状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活 性剤などの成分を添加してもよい。コロイド状シリカと は、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有機溶媒 50 に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~30m

 μ 、好ましくは $10\sim20$ m μ 、固形分濃度が $10\sim4$ 0 重量%程度のものである。このような、コロイド状シ リカとしては、例えば、日産化学工業 (株) 製、メタノ ールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル;触 媒化成工業 (株) 製、オスカルなどが挙げられる。コロ イド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアル ミナゾル520、同100、同200;川研ファインケ ミカル (株) 製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル 10、同132などが挙げられる。有機ポリマーとして は、例えば、ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 10 ン、トリー t ープトキシ・モノ(アセチルアセトナー 合物、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系重合 体、(メタ)アクリル系重合体、芳香族ビニル化合物、 デンドリマー、ポリイミド,ポリアミック酸、ポリアリ ーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキサジ アゾール、フッ素系重合体などを挙げることができる。 界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面活性剤、 アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界 面活性剤などが挙げられ、さらには、シリコーン系界面 活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、ポリ できる。

【0019】本発明の膜形成用組成物の全固形分濃度 は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応 じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30 重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存 安定性もより優れるものである。本発明の膜形成用組成 物はプロピレングリコール含有量が10000ppm以 下、好ましくは5000ppm以下である。プロピレン グリコール含有量が10000ppmを超えると、塗膜 の保存安定性が悪化するという問題が生じやすい。 さら に、本発明の組成物のナトリウム含有量および鉄含有量 がそれぞれ15ppb以下である。ナトリウム含有量お よび鉄含有量のいずれか一方でも15ppbを超える と、塗膜のリーク電流が上昇するという問題が生じやす

【0020】本発明の組成物は、(A)成分を溶剤1に 溶解した、通常触媒および水を添加して(A)成分の加 水分解を行うにより製造する。上記(A)成分を加水分 解、縮合させる際に、(A-1)成分および(A-2) 成分が有するR^{*}O-、R^{*}O-およびR⁵O-で表され る基1モル当たり、0.25~3モルの水を用いること が好ましく、0.3~2.5モルの水を加えることが特 に好ましい。添加する水の量が0.25~3モルの範囲 内の値であれば、塗膜の均一性が低下する恐れが無く、 また、膜形成用組成物の保存安定性が低下する恐れが少 ないためである。さらに、水は断続的あるいは連続的に 添加されることが好ましい。本発明において、(A)成 分を加水分解するときの温度は通常0~100℃、好ま しくは15~80℃である。

【0021】(A)成分を加水分解、縮合させる際に

は、触媒を使用してもよい。この際に使用する触媒とし ては、金属キレート化合物、有機酸、無機酸、有機塩 基、無機塩基を挙げることができる。金属キレート化合 物としては、例えば、トリエトキシ・モノ(アセチルア セトナート) チタン、トリーnープロポキシ・モノ(ア セチルアセトナート) チタン、トリー i ープロポキシ・ モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーローブト キシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーs e c - ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタ ト) チタン、ジエトキシ・ビス (アセチルアセトナー ト) チタン、ジーn-プロポキシ・ビス (アセチルアセ トナート) チタン、ジー i ープロポキシ・ビス(アセチ ルアセトナート) チタン、ジーn-ブトキシ・ビス(ア セチルアセトナート) チタン、ジーsecーブトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーtーブトキ シ・ビス(アセチルアセトナート)チタン、モノエトキ シ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーn ープロポキシ・トリス(アセチルアセトナート)チタ (メタ) アクリレート系界面活性剤などを挙げることが 20 ン、モノー i ープロポキシ・トリス (アセチルアセトナ ート) チタン、モノーnーブトキシ・トリス(アセチル アセトナート)チタン、モノーsecーブトキシ・トリ ス (アセチルアセトナート) チタン、モノーtーブトキ シ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、テトラキ ス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーn-プロ ポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリ - i - プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チ タン、トリーn-ブトキシ・モノ(エチルアセトアセテ 30 ート) チタン、トリーsecーブトキシ・モノ (エチル アセトアセテート) チタン、トリー t ープトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーnープロポキ シ・ビス(エチルアセトアセテート)チタン、ジー i ー プロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、 ジーn-ブトキシ・ビス(エチルアセトアセテート)チ タン、ジーsecーブトキシ・ビス(エチルアセトアセ テート) チタン、ジーtーブトキシ・ビス (エチルアセ トアセテート)チタン、モノエトキシ・トリス(エチル アセトアセテート) チタン、モノーnープロポキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) チタン、モノー i ープ ロポキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノーn-ブトキシ・トリス(エチルアセトアセテー ト) チタン、モノーsecーブトキシ・トリス(エチル アセトアセテート) チタン、モノーtーブトキシ・トリ ス (エチルアセトアセテート) チタン、テトラキス(エ チルアセトアセテート) チタン、モノ(アセチルアセト ナート) トリス (エチルアセトアセテート) チタン、ビ ス (アセチルアセトナート) ビス (エチルアセトアセテ 50 ート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ

(エチルアセトアセテート) チタンなどのチタンキレー ト化合物;トリエトキシ・モノ(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリーn-プロポキシ・モノ(アセ チルアセトナート) ジルコニウム、トリーiープロポキ シ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリ -n-ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーsecーブトキシ・モノ(アセチルアセ トナート) ジルコニウム、トリー t ープトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーn- 10 プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、ジー i ープロポキシ・ビス (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジーnーブトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジー t -ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノエトキシ・トリス(アセチルアセトナート)ジ ルコニウム、モノーnープロポキシ・トリス(アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノーiープロポキシ・ トリス(アセチルアセトナート)ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、モノーsec-ブトキシ・トリス(アセチルア セトナート) ジルコニウム、モノー t - ブトキシ・トリ ス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリエトキシ ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリ - n - プロポキシ・モノ(エチルアセトアセテート)ジ ルコニウム、トリー i ープロポキシ・モノ(エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、トリーnーブトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリーs 30 e c ープトキシ・モノ(エチルアセトアセテート)ジル コニウム、トリー t ーブトキシ・モノ(エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジエトキシ・ビス(エチルア セトアセテート) ジルコニウム、ジーnープロポキシ・ ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジー i ープロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、ジーnープトキシ・ビス(エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ビス (エ チルアセトアセテート) ジルコニウム、ジー t ープトキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モ 40 ノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、モノーnープロポキシ・トリス(エチルアセト アセテート) ジルコニウム、モノー i ープロポキシ・ト リス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、モノーsecーブトキシ・トリス(エチルア セトアセテート) ジルコニウム、モノーtーブトキシ・ トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、テト ラキス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテ 50

ート) ジルコニウム、ビス (アセチルアセトナート) ビー ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト)ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物; トリス (アセチルアセトナート) アルミニウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウムなどのアルミ ニウムキレート化合物;などを挙げることができる。 【0022】有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオ ン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン 酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレ イン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没 食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、 2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リ ノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、 p ー アミノ安息香酸、pートルエンスルホン酸、ベンゼンス ルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ 酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン 酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸などを挙げ ることができる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝 20 酸、硫酸、フッ酸、リン酸などを挙げることができる。 【0023】有機塩基としては、例えば、ピリジン、ピ ロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリ ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、モノエタノ ールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノ ールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシク ロノナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルア ンモニウムハイドロオキサイドなどを挙げることができ

ルシウムなどを挙げることができる。 【0024】これら触媒のうち、金属キレート化合物、 有機酸、無機酸が好ましく、より好ましくは、チタンキ レート化合物、有機酸を挙げることができる。これらは 1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

る。無機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナ

トリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化カ

【0025】上記触媒の使用量は、(A)成分(完全加水分解縮合物換算)の合計量100重量部に対して、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~10重量部の範囲である。また、触媒は、前記溶剤中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。

【0026】本発明において、膜形成用組成物中の沸点 100℃以下のアルコールの含量が、20重量%以下、 特に5重量%以下であることが好ましい。沸点100℃ 以下のアルコールは、上記(A-1)成分ならびに(A -2)成分の加水分解および/またはその縮合の際に生 じる場合があり、その含量が20重量%以下、好ましく は5重量%以下になるように蒸留などにより除去するこ とが好ましい。

O 【0027】本発明の組成物を、シリコンウエハ、Si

O2 ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際に は、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー 法などの塗装手段が用いられる。

【0028】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗 りで厚さ 0. 05~1. 5μm程度、2回塗りでは厚さ 1~3 μ m程度の塗膜を形成することができる。そ の後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度 の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥するこ とにより、ガラス質または巨大髙分子の絶縁膜を形成す ることができる。この際の加熱方法としては、ホットプ 10 レート、オーブン、ファーネスなどを使用することが出 来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴ ン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下 などで行うことができる。

【0029】このようにして得られる層間絶縁膜は、絶 縁性に優れ、塗布膜の均一性、誘電率特性、塗膜の耐ク ラック性、途膜の表面硬度に優れることから、LSI、 システムレシ、DRAM、SDRAM、RDRAM、D - R D R A M などの半導体素子用層間絶縁膜、半導体素 子の表面コート膜などの保護膜、多層配線基板の層間絶 縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁防止膜などの用途 に有用である。

[0030]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体 的に説明する。なお、実施例および比較例中の部および %は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%で あることを示している。また、実施例中における膜形成 用組成物の評価は、次のようにして測定したものであ

【0031】<u>重量平均分子量(Mw)</u>

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ - (GPC) 法により測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、加水分 解縮合物1gを、100ccのテトラヒドロフランに溶 解して調製した。

標準ポリスチレン:米国プレッシャーケミカル社製の標 準ポリスチレンを使用した。

装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマ トグラム (モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M 40 (長さ50cm)

測定温度:40℃

流速:1cc/分

【0032】膜厚均一性

形成用組成物を、8インチシリコンウエハ上に、スピン コーターを用いて、回転数1,700грm、30秒の 条件で以て塗布した。その後、95℃の温度に保持した ホットプレートを用いて、膜形成用組成物を塗布したシ リコンウエハを5分間加熱し、有機溶媒を飛散させた。 次いで、210℃の温度に保持したホットプレートを用 50 〇;リーク電流が7×10⁻¹⁰ A未満

いて、膜形成用組成物を塗布したシリコンウエハを 5 分 間加熱し、シリコンウエハ上に塗膜を形成させた。この ようにして得られた塗膜の膜厚を、光学式膜厚計(Ru dolph Technologies社製、Spec tra Laser200) を用いて塗膜面内で50点 測定した。得られた膜厚の 3 σ を計算し、下記基準で評

〇:塗膜の3σが35nm未満

【0033】保存安定性

37℃で35日保存した膜形成用組成物を、8インチシ リコンウエハ上に、スピンコーターを用いて、回転数 1, 700 r p m、30 秒の条件で以て塗布した。その 後、95℃の温度に保持したホットプレートを用いて、 膜形成用組成物を塗布したシリコンウエハを5分間加熱 し、有機溶媒を飛散させた。次いで、210℃の温度に 保持したホットプレートを用いて、膜形成用組成物を塗 布したシリコンウエハを5分間加熱し、シリコンウエハ 上に塗膜を形成させた。このようにして得られた塗膜の 膜厚を、光学式膜厚計 (Rudolph Techno logies社製、Spectra Laser20 0)を用いて塗膜面内で50点測定した。得られた膜厚 の膜厚を測定し、下式により求めた膜厚増加率により、 保存安定性を評価した。

膜厚増加率 (%) = ((保存後の膜厚) - (保存前の膜 厚)) ÷ (保存前の膜厚) × 1 0 0

○: 膜厚変化率 ≤10%

△:10%< 膜厚変化率 ≦20%

x:20%< 膜厚変化率

【0034】誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で95℃で5分 間、210℃で5分間基板を乾燥し、さらに450℃の 真空雰囲気のオーブン中で70分基板を焼成した。得ら れた基板上にアルミニウムを蒸着し、誘電率評価用基板 を作製した。誘電率は、横川・ヒューレットパッカード (株) 製のHP16451B電極およびHP4284A プレシジョンLCRメーター用いて、10kHzにおけ る容量値から算出した。

【0035】リーク電流

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で95℃で5分 間、210℃で5分間基板を乾燥し、さらに450℃の 真空雰囲気のオーブン中で70分基板を焼成した。得ら れた基板上にアルミニウムを蒸着し、リーク電流評価用 基板を作製した。リーク電流は、Keithley

(株) 製の6517Aを使用し、塗膜に0.2MV/c mの電圧を印可した際の電流値を測定した。下記基準で **塗膜のリーク電流を評価した。**

×:リーク電流が7×10¹⁰ A以上

【0036】合成例1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン135.7gとビス(トリエトキシシリル)メタン 48.2gとジイソプロポキシチタンビスエチルアセチ ルアセテート1.1gを、石英容器用いて2回蒸留精製 したプロピレングリコールモノプロピルエーテル135 gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、 溶液温度を60℃に安定させた。次に、イオン交換水7 5gを1時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で 2時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。こ の反応液に、石英容器用いて2回蒸留精製したプロピレ ングリコールモノプロピルエーテル190gを添加し、 50℃で反応液からメタノールおよびエタノールを含む 溶液を190gエバポレーションで除去し、反応液 Φを 得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子 量は、5,700であった

19

【0037】合成例2

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン101.8gと1,1,3,3-テトラエトキシー 1, 3-ジメチルシロキサン70.4gを、石英容器用 いて2回蒸留精製したプロピレングリコールモノメチル エーテル159gに溶解させたのち、スリーワンモータ ーで攪拌させ、溶液温度を60℃に安定させた。次に、 マレイン酸4.4gを溶解させたイオン交換水70gを 1時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間 反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。この反応 液に、石英容器用いて2回蒸留精製したプロピレングリ コールモノメチルエーテル 2 1 0 g を添加し、50℃で 反応液からメタノールおよびエタノールを含む溶液を 2 10gエバポレーションで除去し、反応液 ②を得た。こ のようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、 4,000であった。

【0038】比較合成例1

合成例1において、蒸留精製を行っていないプロピレン グリコールモノプロピルエーテルを使用した以外は合成 例1と同様に反応を行い、重量平均分子量5,500の 反応液③を得た。

【0039】実施例1

合成例1で得られた反応液Φを0.2μm孔径のテフロ ン製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を 得た。得られた組成物のプロピレングリコール含有量は 200ppm、ナトリウム含有量は1.2ppb、鉄含 有量は1.8ppbであった。得られた組成物をスピン コート法でシリコンウエハ上に塗布した。 得られた塗膜 の途膜の膜厚は475 n m であり、3 σ は8. 4 n m と 良好であった。溶液の保存安定性を評価したところ、3 5日後の増膜率は4.3%と優れた保存安定性を示し た。また、塗膜の誘電率を評価したところ、2.69と 低い誘電率を示した。さらに、塗膜のリーク電流を評価 50 た。溶液の保存安定性を評価したところ、35日後の増

したところ、1. 2×10³ Aと低いリーク電流が得

【0040】実施例2

合成例2で得られた反応液 Φを使用した以外は、実施例 1と同様にして評価を行った。得られた組成物のプロピ レングリコール含有量は205ppm、ナトリウム含有 量は1.8ppb、鉄含有量は2.2ppbであった。 得られた塗膜の塗膜の膜厚は433nmであり、3σは 9. 9 n m と良好であった。溶液の保存安定性を評価し たところ、35日後の増膜率は8.1%と優れた保存安 定性を示した。また、塗膜の誘電率を評価したところ、 2. 70と低い誘電率を示した。さらに、塗膜のリーク 電流を評価したところ、1.8×10⁻° Aと低いリー ク電流が得られた。

【0041】実施例3

合成例1で得られた反応液**①**100gにアセチルアセト ン1gを添加した溶液を使用した以外は実施例1と同様 にして評価を行った。得られた組成物のプロピレングリ コール含有量は198ppm、ナトリウム含有量は1. 1 p p b、鉄含有量は1.7 p p b であった。得られた **塗膜の塗膜の膜厚は470nmであり、3σは8.4n** mと良好であった。溶液の保存安定性を評価したとこ ろ、35日後の増膜率は3.9%と優れた保存安定性を 示した。また、金膜の誘電率を評価したところ、2.7 0と低い誘電率を示した。さらに、塗膜のリーク電流を 評価したところ、1.5×10^{1。}Aと低いリーク電流 が得られた。

【0042】実施例4

合成例2で得られた反応液②100gに重量分子量約 30 4,000のポリメタクリル酸イソプロピル10gを添 加した溶液を使用した以外は実施例1と同様にして評価 を行った。得られた組成物のプロピレングリコール含有 量は205ppm、ナトリウム含有量は2.5ppb、 鉄含有量は3.3 p p b であった。得られた塗膜の塗膜 の膜厚は399nmであり、3σは10.3nmと良好 であった。溶液の保存安定性を評価したところ、35日 後の増膜率は8.9%と優れた保存安定性を示した。ま た、塗膜の誘電率を評価したところ、2.32と低い誘 電率を示した。さらに、塗膜のリーク電流を評価したと ころ、0.8×10¹ Aと低いリーク電流が得られ た。

【0043】 実施例5

合成例2で得られた反応液②100gに重量分子量約 2,000のポリエチレングリコール10gを添加した 溶液を使用した以外は実施例1と同様にして評価を行っ た。得られた組成物のプロピレングリコール含有量は2 05ppm、ナトリウム含有量は3.4ppb、鉄含有 量は5.2ppbであった。得られた塗膜の塗膜の膜厚 は393nmであり、3σは10.2nmと良好であっ

膜率は9.1%と優れた保存安定性を示した。また、塗膜の誘電率を評価したところ、2.22と低い誘電率を示した。さらに、塗膜のリーク電流を評価したところ、0.6×10¹⁰ Aと低いリーク電流が得られた。

【0044】比較例1

比較合成例1で得られた反応液 ③を使用した以外は、実施例1と同様にして評価を行った。得られた組成物のプロピレングリコール含有量は15000ppm、ナトリウム含有量は53ppb、鉄含有量は88ppbであった。得られた塗膜の塗膜の膜厚は476nmであり、3σは40.2nmと塗膜均一性に劣るものであった。溶

液の保存安定性を評価したところ、35日後の増膜率は13.4%と保存安定性に劣るものであった。また、塗膜の誘電率を評価したところ、3.02と高い誘電率を示した。さらに、塗膜のリーク電流を評価したところ、19.5×10¹⁰ Aと高いリーク電流が得られた。

22

【発明の効果】本発明によれば、アルコキシシランの加水分解物および/またはその縮合物を特定の純度の溶媒に溶解させることにより、塗膜均一性、保存安定性、誘電率、リーク電流特性などのバランスに優れた膜形成用10 組成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能である。

フロントページの続き

(72) 発明者 山田 欣司 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 F ターム(参考) 4J002 CP031 EA016 EE026 EE048 EH026 EP016 EV206 EZ007 GQ01

> 5F058 AA03 AA10 AC03 AF04 AG01 AH01 AH02 BA06 BA20 BC05 BF46 BH01 BJ01 BJ02